展望

2023トップインタビュー

バルカー

先端半導体関連 攻めの投資

本坊 吉博 社長COO

◆…前年度に続き業績の過去最高値更新を予想します。

「半導体製造装置用高機能シール製品や薬液貯蔵用ライニングタンク（特殊タンク）の販売増に加え、プラント向けシール製品や一般産業機械および輸送機器向けの樹脂加工製品も堅調に推移する。汎用製品を中心とした生産体制の最適化や国内販売体制の集約効果も実感している。各事業とも環境の変化に対応できる地力がついてきた」

◆…半導体市場についてはどうみますか。

「企業のIT投資の規模をみていると、コロナ禍で拡大したものが一服してきている印象だ。半導体市場は汎用メモリーを中心に調整段階となっているが、先端品については各領域で開発を加速している。当社の両製品とも先端品に強みを持つことから、市況影響はあまり感じていない。むしろ、計画以上の需要拡大がみえてきたことから継続的な能力増強を検討している」

◆…その増強の構想は。

「これまで高機能シール製品はマザー工場である奈良県五條市の拠点や韓国拠点で増強し、特殊タンクは台湾の新工場稼働など体制を強化してきた。半導体は成長産業であることは間違いなく、先端品とのかかわりを徹底的に追求していくためには関連製品の増強投資が必要だ。半導体産業の国内回帰や地政学的リスク、公的な補助金の活用を考え、日本での投資を最優先に計画を詰めているところだ。顧客から海外生産の拡大といった要望もいただいているが、まずは現地の既存拠点を活用していく考えだ」

◆…石化プラント向け製品は。

「顧客が調達を不安視してか、受注の前倒しが進んでいることから、来期の販売に影響が出そうだ。また、石油化学産業の脱炭素化など中長期的な動向も注視したい」

◆…フッ素系材料の調達はいかがでしょうか。

「情報収集と新規調達先の探索を進め、ギリギリなところでしのいでいる状況だ。価格より安定性を重視し多角的な視点で原材料メーカーとの連携を深めていきたい」

◆…M&A（合併・買収）については。

「今期スタートした中期経営計画では、80億円程度のM&A投資枠を設定した。現在、複数企業と議論が進むが、いずれも当社にない優れた技術を取り入れ未開拓領域への参入につなげたい。石化プラント向けシール製品やフッ素樹脂加工製品の一部では外部生産が始まっているが、国内の優れた加工技術との融合を図り、新たな価値を創出したい」

◆…デジタルソリューションについては。

「クラウドプラットフォームをベースとした予知保全や高度遠隔監視をキーワードとした振動検知やパッキンの交換時期予測サービスなどが揃ってきた。ユーザーとの共同検証プロジェクトも進む。回路設計に強みを持つコネクテックジャパンや人工知能（AI）のリッジアイと資本提携を結び、複数のプロジェクトを進めている」

◆…来期の取り組みは。

「厳しい環境が予測されるが、中期経営計画の最終年度としての活動と2027年の創業100周年、そしてその先を見据えた成長の道筋を考えたい」

（阿桑健太郎）

記者の視点

先端半導体関連品では世界視点での体制強化を積極的に進め、既存製品ではデジタルソリューションとの融合を図り領域拡大と付加価値向上を実現する。「社内には期待の人材が豊富」と語る。化学業界を中心とした幅広いネットワークの世代間共有を進めるとともに、これまでの経験で培ったビジネスにおける現実解の導き方を伝えていく。